



GlobalWafer Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT) 2025 年第三季營運報告

2025/11/04





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

■ 營業收入

- ✓ 2025年第三季→ 新台幣145億元，季減9.46%
- ✓ 2025年前三季→ 新台幣461億元，年減0.40%

■ 營業毛利率

- ✓ 2025年第三季→ 18.4%
- ✓ 2025年前三季→ 23.6%

■ 營業淨利率

- ✓ 2025年第三季→ 8.5%
- ✓ 2025年前三季→ 13.6%



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

■ 稅後淨利率

- ✓ 2025年第三季→ 13.6%
- ✓ 2025年前三季→ 11.1%

■ 每股盈餘

- ✓ 2025年第三季→ 新台幣4.12元
- ✓ 2025年前三季→ 新台幣10.68元

■ 預收貨款

- ✓ 新台幣265億元 (美金8.7億元)¹



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 全球經濟

- ✓ 通膨與政策支撐：**通膨預期維持穩定**，為各國央行降息並支撐經濟成長提供空間。然而，高關稅與政策不確定性仍對消費需求與企業投資造成壓力。
- ✓ 韌性因素：全球 GDP 預期於 2024 至 2026 年間逐步放緩，但**在美國強勁的 AI 投資帶動下**，整體展現韌性。
- ✓ 區域展望：全球經濟成長因地區而異。美國面臨關稅壓力與就業放緩，消費支出開始減弱；歐洲在能源與貿易風險下，GDP 與通膨逐步改善；亞太地區成長溫和放緩，而中國則面臨通膨上升與經濟成長趨緩的挑戰。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 半導體市場

- ✓ 半導體市場在 AI 相關先進製程領域展現強勁動能，但普遍與成熟製程仍維持保守態勢。AI 與先進邏輯製程成為主要營收成長動力，受雲端與超大型資料中心投資帶動；相對地，成熟製程及消費性應用相關市場表現仍顯低迷。
- ✓ 雖然受 AI 帶動的單價 (ASP) 上升使半導體營收快速回升，但晶圓出貨量反映的復甦幅度較為溫和，顯示營收成長與實際晶圓需求之間出現落差。
- ✓ 貿易緊張與關稅政策可能進一步影響區域需求。整體而言，產業循環正處於回升階段，但復甦力道脆弱且結構分化，推動各地區加速在地替代布局。
- ✓ 展望未來，隨著市場庫存調整接近尾聲，AI 應用持續擴展至更多產業領域，晶圓需求可望穩步回升。環球晶圓將持續強化技術與營運效率，深化全球布局與在地供應能力，並掌握 AI、高效能運算與在地化趨勢帶來的長期機會，延續產業復甦動能，推動永續成長。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 環球晶圓的全球擴產與區域布局

- ✓ 環球晶圓的擴產計畫正於美國與歐洲穩健推進，並與亞洲既有據點同步發展，逐步建構具韌性的全球生產網絡。
- ✓ 義大利諾瓦拉新產線的啟用，是環球晶圓在歐洲的重要里程碑，助力該地區的再生能源與供應鏈強化。環球晶圓持續深化客戶合作與在地化製造，以提升營運彈性與市場貼近度，進一步鞏固公司的全球韌性與長期競爭力。諾瓦拉廠與歐洲其他基地、美洲及亞洲廠區相互連結，共同構成環球晶圓全球生產網絡的關鍵樞紐。

■ 環球晶圓的新材料研發與技術發展

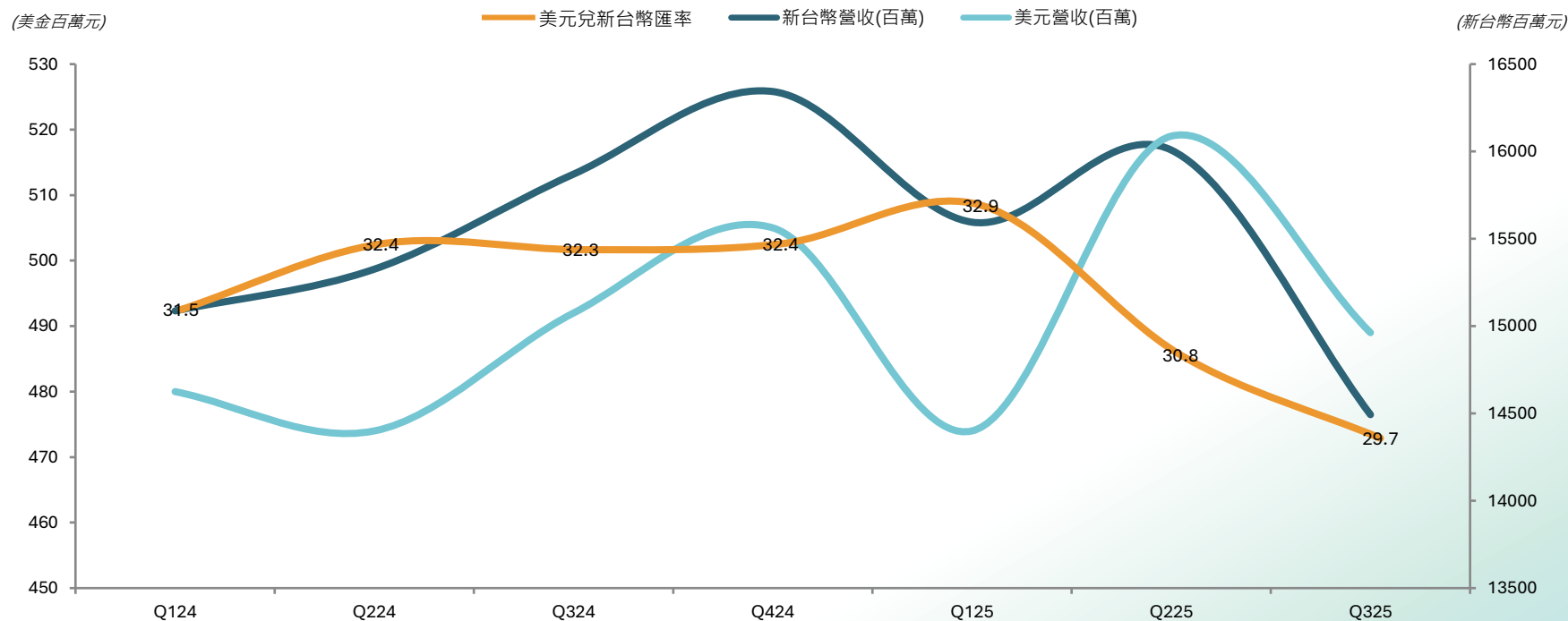
- ✓ 環球晶圓依循長期技術發展藍圖，持續強化先進材料領域的研發能力。在矽領域的深厚基礎之上，公司推進方形矽晶圓與 12 吋碳化矽 (SiC) 晶圓的開發，展現大尺寸材料研究與製程開發的穩健進展，為下一代晶圓技術奠定基礎。



以美元計算之營運表現穩定

- 新台幣在 2025 年上半年明顯升值，8 月後雖略有轉弱，但仍持續對以新台幣計算的營收造成壓力。由於環球晶圓的營收主要以美元計價，匯率升值使得以新台幣換算後的表現顯得較為疲弱。
- 以美元計算，環球晶圓 2025 年第三季營收為 4.9 億美元（季減 5.95%、年減 0.66%），**前三季累計營收達 14.8 億美元，年增 2.45%**，年營收變動率由台幣計價的下滑轉為美元計價的成長。

新台幣營收與美元營收及匯率比較





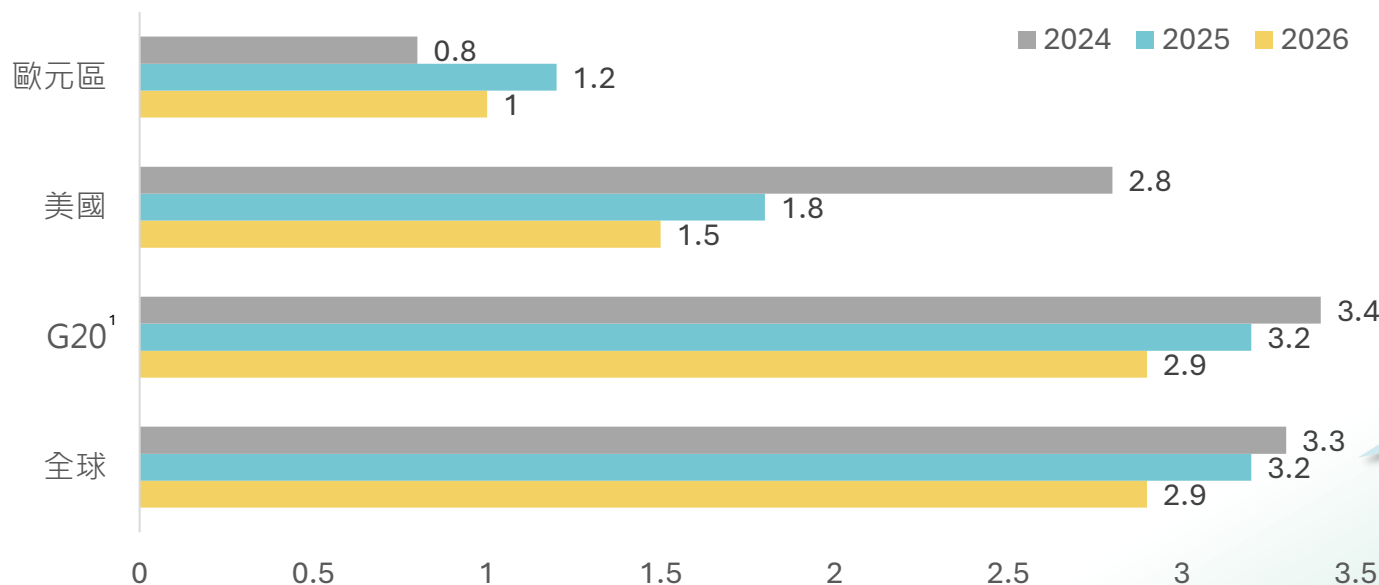
02

產業概況

貨幣政策與 AI 投資支撐經濟韌性

- **通膨預期維持穩定**，讓各國央行得以持續降息，進一步**改善金融環境**，並在高關稅與經濟不確定性下，仍能**帶動消費與投資動能**。
- **全球成長韌性**：全球 GDP 預估將由 2024 年的 3.3% 逐步放緩至 2025 年的 3.2% 及 2026 年的 2.9%，在關稅與不確定性環境中**仍展現韌性**，主要受美國強勁的 AI 投資支撐。
- **貨幣政策順風**：主要經濟體的降息循環有望改善金融條件，提振消費與投資，並對整體經濟活動帶來正面影響。

2024、2025、2026 年實質 GDP 成長率預測 (年增率, %)



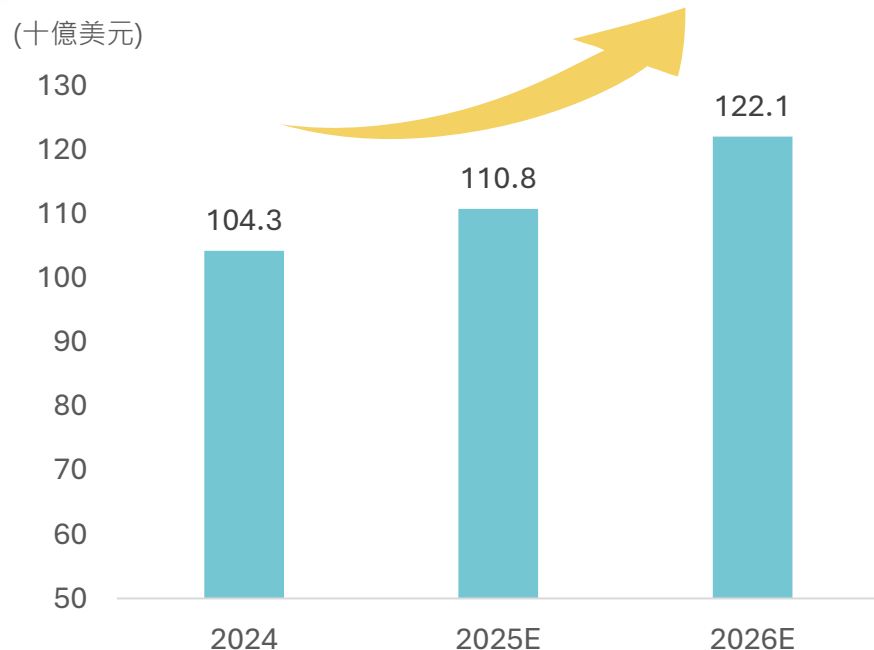
在關稅與不確定性環境下，**全球 GDP 仍展現韌性**，主要受到美國強勁 AI 投資的支撐



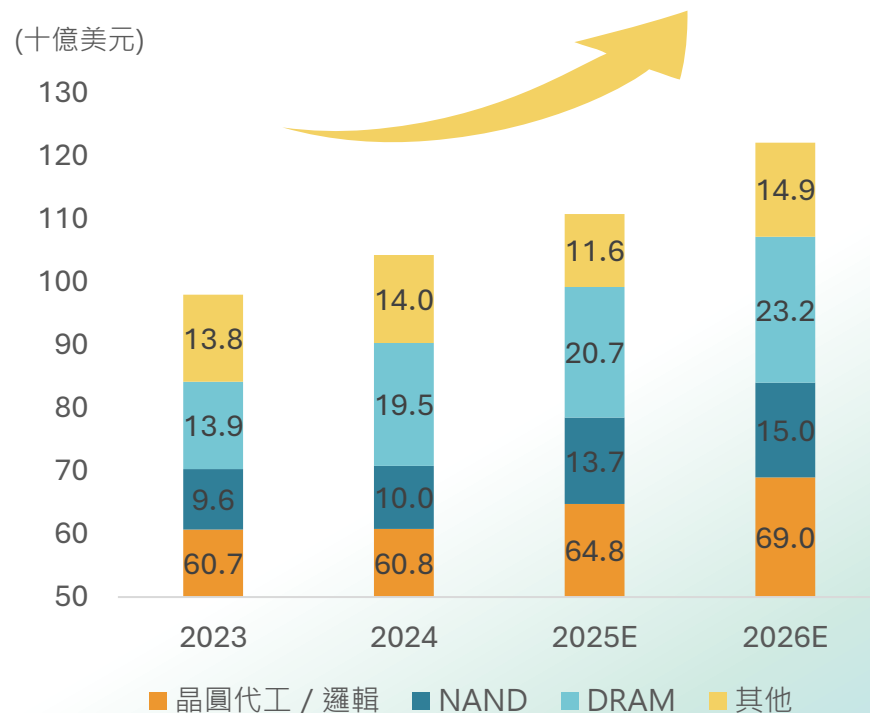
AI 與先進製程推動晶圓製造設備市場成長

- **晶圓製造設備市場加速成長**：受 AI 結構性成長帶動，晶圓製造設備（WFE）市場預估將於 2025 年達 1,108 億美元，2026 年進一步成長至 1,221 億美元。隨著 2 奈米製程量產推進與記憶體需求回升，晶圓代工與邏輯製程設備市場預計將於 2025 年成長 6.7% 至 648 億美元，2026 年再增長 6.6% 至 690 億美元。
- **環球晶圓與產業趨勢同步推進**：環球晶圓透過擴充 AI、高效能運算（HPC）、功率元件與感測應用相關產能，積極掌握此波結構性成長契機，確保稼動率、營運穩定性，並為下一世代製程技術做好準備。

各晶圓製造設備市場銷售分布（依產品類別）



各應用領域的晶圓製造設備（WFE）銷售分布

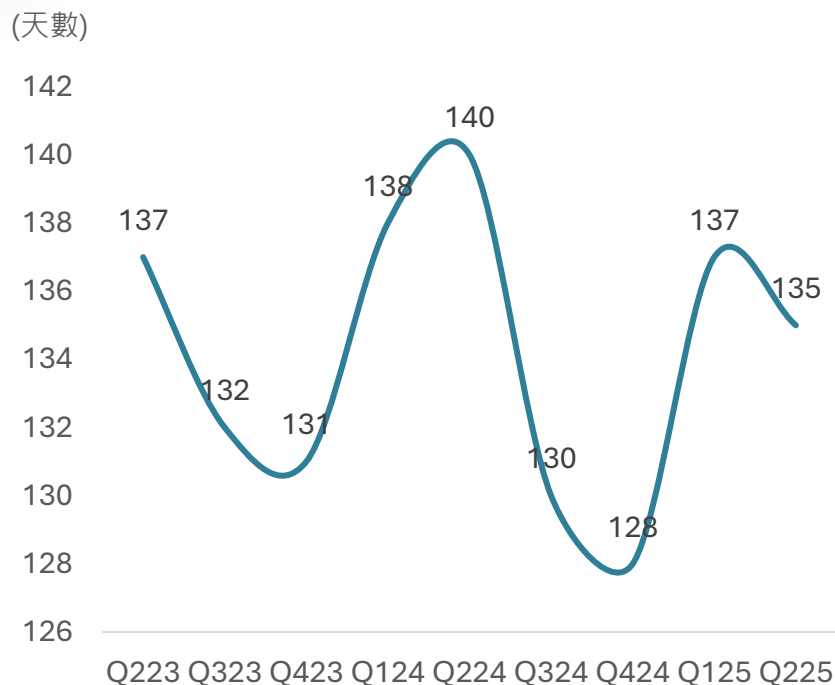




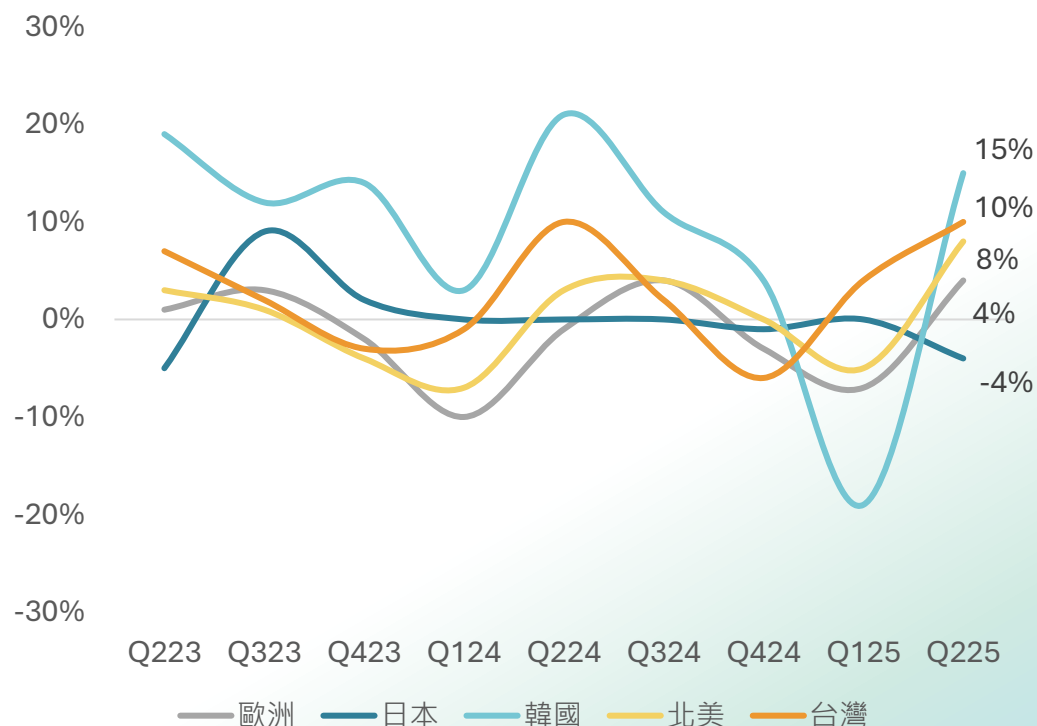
市場止跌跡象初現，展望仍趨審慎

- **庫存趨勢逐步改善**：因關稅引發的短期庫存上升在 2025 年初出現，但至第二季已回落至約 135 天，顯示**終端客戶正逐步消化既有庫存**。
- **區域表現分歧**：**多數地區呈現季增走勢**，但受 2025 年第二季高基期影響，成長動能受限，日本市場復甦仍顯緩慢。除 AI 應用外，整體市場能見度仍屬中性，AI 帶動的需求為主要成長動能。

全球半導體庫存天數 (2023 年第 2 季至 2025 年第 2 季)



全球客戶各區季度營收成長率¹

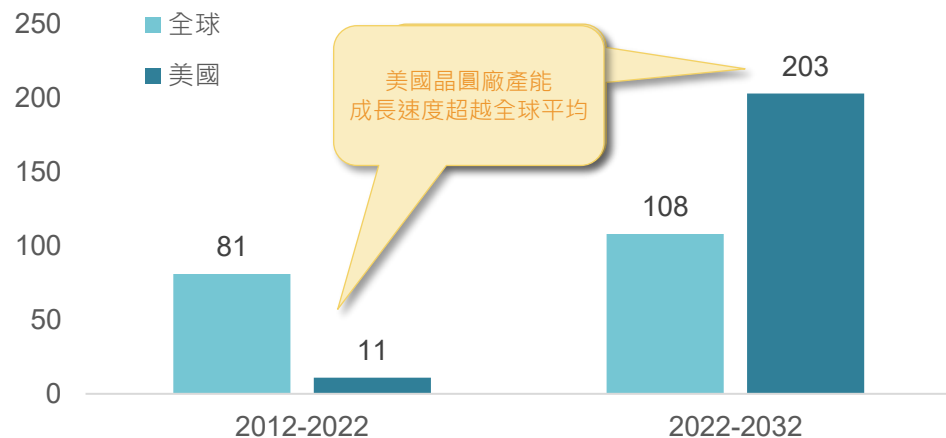


美國晶片回流與環球晶圓擴產布局

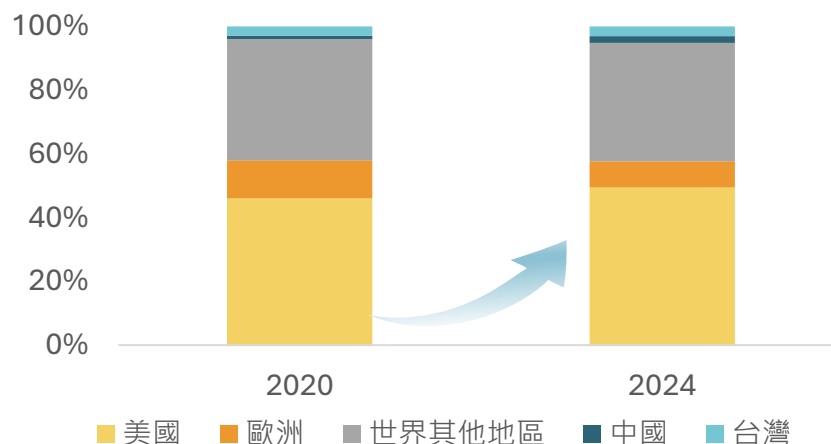
- **美國回流與投資加速**：美國正迅速重建其晶片生態系，已宣布的民間投資總額**超過 5,000 億美元**，預計至 2032 年將使美國本土**晶片製造產能增加三倍**，並創造**超過 50 萬個就業機會**。
- 隨著美國晶圓廠產能成長速度超越全球平均、整合元件製造商 (IDMs) 與純晶圓代工廠 (Pure-Play Foundries) 的晶片銷售均呈現上升趨勢，環球晶圓的擴產布局正好掌握成長契機，進一步強化美國在全球市場的佔比。

美國晶圓廠產能預期增幅 vs 全球平均

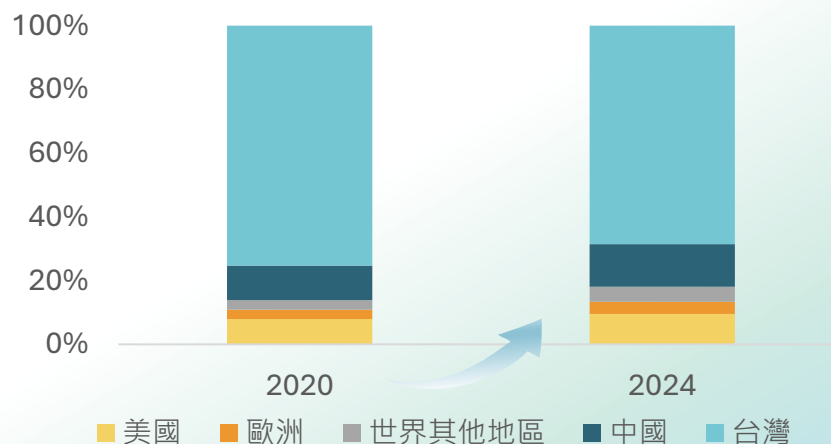
(產能變動百分比)



依價值鏈與地區劃分的半導體銷售額 (2020-2024 年) — 整合元件製造商 (IDMs)



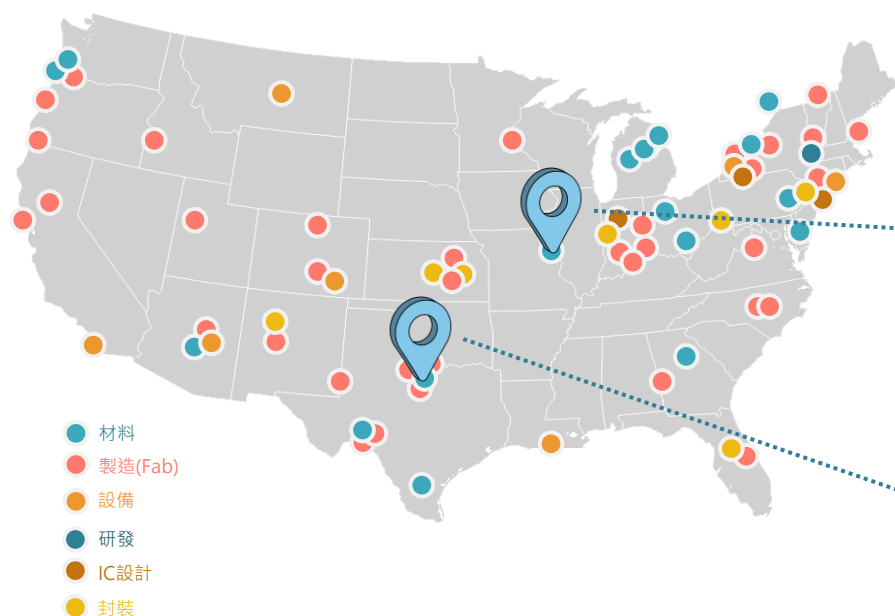
依價值鏈與地區劃分的半導體銷售額 (2020-2024 年) — 純晶圓代工廠 (Pure-Play Foundries)



美國擴產進度：強化半導體供應鏈

- 近年來，全球半導體業者陸續在美國進行大規模的供應鏈投資，涵蓋製造、設備、材料、研發、設計及先進封裝等領域，推動區域性產業聚落的快速形成。
- 環球晶圓在美國的據點策略性布局於主要產業聚落中——德州 (GWA) 為旗艦 12 吋晶圓廠，密蘇里州 (MEMC) 則為 SOI 與矽光子的重要生產中心，整體擴產計畫將持續支援客戶的在地化策略。

2020-2025 年半導體供應鏈投資宣布



環球晶圓美國廠區擴產進度



MEMC LLC (密蘇里州)

- 試產已於 2025 年 5 月啟動，預計於 2026 下半年達到產能滿載
- RF-SOI 與矽光子 需求強勁，已有多家客戶提出樣品需求



GWA (德州)

- 驗證進程加速中，與客戶需求保持一致
- 產能將於驗證完成後逐步提升，確保市場彈性

FAB300啟用典禮：歐洲一貫製程12吋晶圓廠

- 環球晶圓於 2025 年 10 月在義大利諾瓦拉正式啟用 FAB300，總投資額達 4.5 億歐元，並將獲得 1.03 億歐元的 IPCEI 補助。
FAB300 是歐洲少數具備一貫製程整合能力的 12 吋晶圓廠之一，創造 150 個專業職缺，強化歐洲半導體生態系。該廠已開始提供樣品與小量出貨。
- FAB300 將生產應用於邏輯晶片、記憶體、功率元件與感測器的拋光晶圓與磊晶晶圓，全面使用再生能源，符合 RE100 標準，並以約 50% 的製程用水回收率為目標。FAB300 與美國及亞洲廠區緊密連結，確保全球布局一致，同時維持強而有力的區域生產能量。

強化歐洲半導體生態系



專業就業機會

創造 150 個就業機會
強化當地專業能量



12 吋產品組合

拋光晶圓與磊晶晶圓
應用於邏輯、記憶體、功率與感測器

供應鏈與永續發展優勢



完整垂直整合的價值鏈

從晶體生長到晶圓成品



符合 RE100 標準

100% 使用再生能源，製程用水回收率約 50%



全球營運韌性

美國、亞洲與歐洲據點相互呼應

次世代晶圓研發進展

- 環球晶圓持續依循技術藍圖推進新材料開發，已完成**方形矽晶圓**與**12 吋碳化矽 (SiC) 晶圓**的原型製作，並進入送樣與小量生產階段。
- 憑藉深厚的晶圓製造經驗與設備技術能力，環球晶圓穩步克服大尺寸晶圓與方形晶圓技術的挑戰，並透過持續的研發投入與專利布局，強化長期競爭力。

技術進展



原型開發

方形矽晶圓與 12 吋碳化矽晶圓，
已完成送樣與小量生產



製程技術

已克服切割、研磨、拋光與清洗等
關鍵製程挑戰



能力延伸

運用 12 吋矽晶圓與小尺寸碳化矽晶圓
製造經驗，降低新技術導入風險



研發投資

廣泛的專利布局



共同開發

共同開發設備；強化供應鏈與產業生態系

市場潛力



▲ 方形晶圓

2.5D / 3D 封裝趨勢

方形矽晶圓：
兼具大面積設計與材料利用優勢

AI / 高效能運算功率密度提升

12 吋碳化矽晶圓：
優異的散熱與熱管理性能

03

營運概況



財務摘要：2025年第三季 vs. 2025年第二季 vs. 2024年第三季

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2025年第三季	2025年第二季	2024年第三季	季成長	年成長
營業收入	14,493	16,008	15,870	-9.5%	-8.7%
營業毛利 %	18.4%	25.8%	30.0%	-7.4p.p.	-11.6p.p.
營業淨利	1,230	2,438	3,200	-49.6%	-61.6%
營業淨利 %	8.5%	15.2%	20.2%	-6.7p.p.	-11.7p.p.
本期淨利	1,969	1,682	2,952	17.1%	-33.3%
本期淨利 %	13.6%	10.5%	18.6%	3.1p.p.	-5.0p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$4.12	NT\$3.52	NT\$6.18	NT\$0.6	-NT\$2.06
EBITDA* ²	4,376	4,472	5,024	-2.1%	-12.9%
EBITDA %	30.2%	27.9%	31.7%	2.3p.p.	-1.5p.p.
EBIT ³	2,013	2,027	2,922	-0.7%	-31.1%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	9.0%	7.6%	12.8%	1.4p.p.	-3.8p.p.
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	4.2%	3.4%	5.4%	0.8p.p.	-1.2p.p.
資本支出 ⁶	7,018	7,537	14,699	-	-
折舊費用	2,357	2,440	2,097	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款



財務摘要：2025年前三季 vs. 2024年前三季(累計)

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2025年前三季	2024年前三季	年成長
營業收入	46,096	46,283	-0.4%
營業毛利 %	23.6%	32.2%	-8.6p.p.
營業淨利	6,257	10,534	-40.6%
營業淨利 %	13.6%	22.8%	-9.2p.p.
本期淨利	5,107	9,364	-45.5%
本期淨利 %	11.1%	20.2%	-9.1p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$10.68	NT\$20.19	-NT\$9.51
EBITDA* ²	12,880	15,506	-16.9%
EBITDA %	27.9%	33.5%	-5.6p.p.
EBIT ³	5,817	9,561	-39.2%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	7.5%	15.5%	-8.0p.p.
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	3.4%	6.3%	-2.9p.p.
資本支出 ⁶	26,112	37,836	-
折舊費用	7,047	5,929	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產

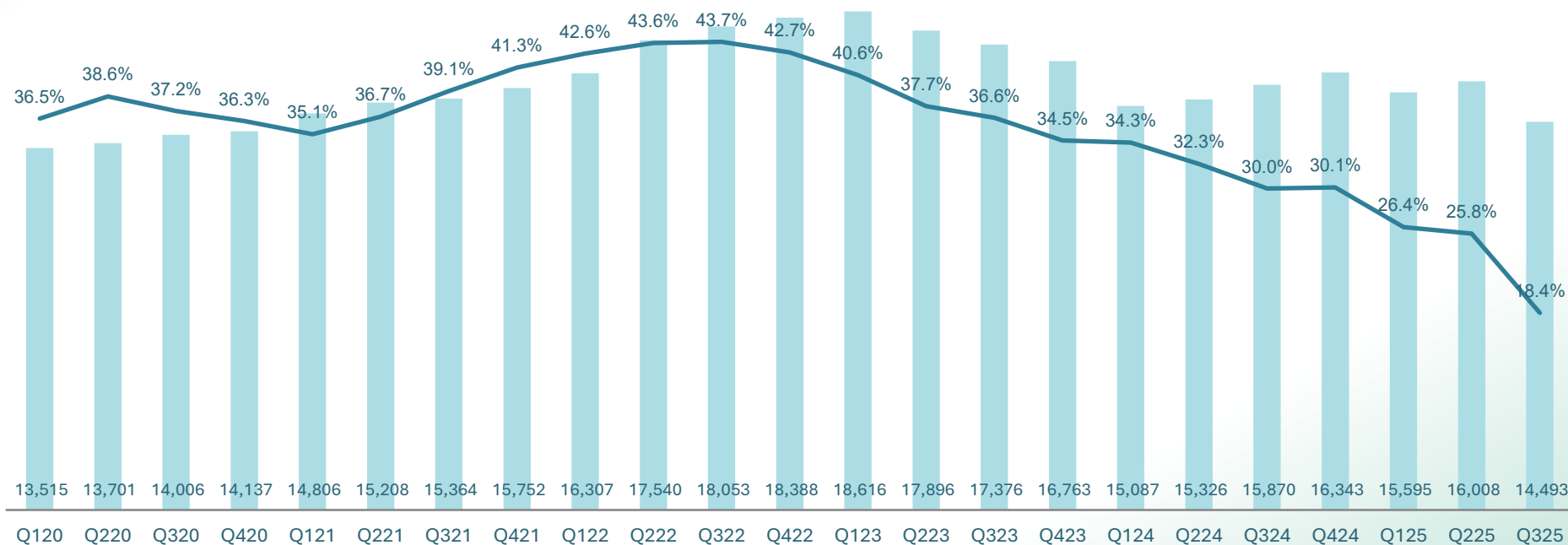


營業收入 & 營業毛利率(%)

營業收入 & 營業毛利率 (%)

(新台幣百萬元)

營業收入 營業毛利率 (%)



備註: 1. 2025 年第 3 季毛利率季減，主要原因包括折舊比例增加、夏季電費與人力成本比例上升，以及擴產相關成本



EBITDA & 每股盈餘

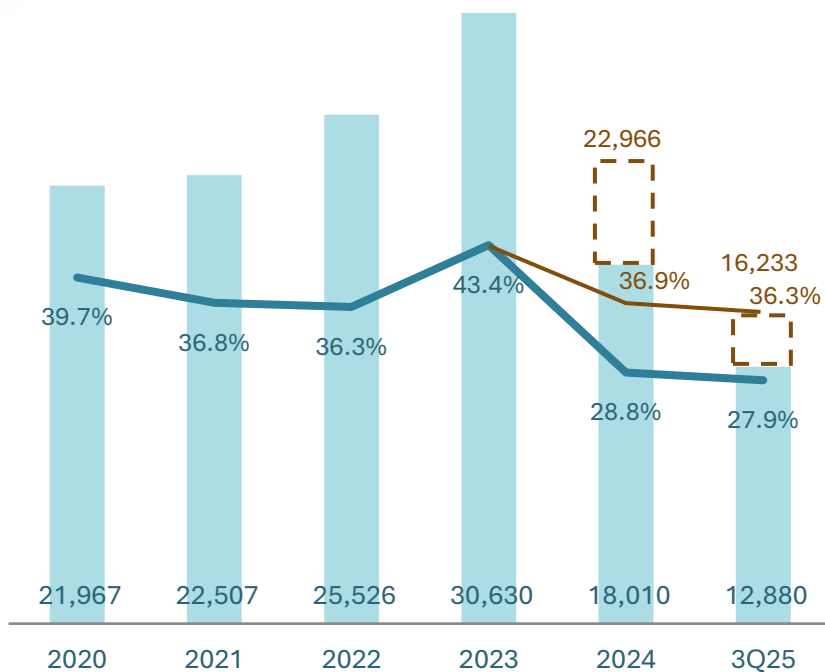
EBITDA

(新台幣百萬元)

■ EBITDA

— EBITDA / 營業收入

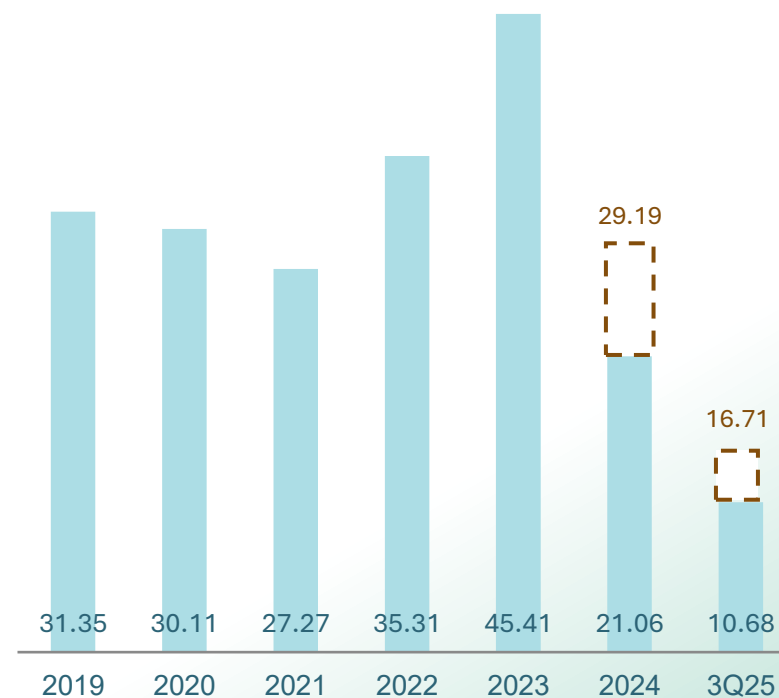
在排除持有 Siltronic 股份的市值評價變動影響，並假設未有重大擴產計畫的情況下，EBITDA 呈現成長趨勢



每股盈餘

(新台幣元)

在排除持有 Siltronic 股份的市值評價變動影響，並假設未有重大擴產計畫的情況下，每股盈餘呈現成長趨勢





損益表

新台幣百萬元	2024	Q125	Q225	Q325	3Q25	3Q25 (模擬) ¹
營業收入	62,626	15,595	16,008	14,493	46,096	44,759
成長率 (%) ²	-11.4%	3.4%	4.5%	-8.7%	-0.4%	-
營業毛利	19,804	4,112	4,123	2,662	10,897	13,953
營業毛利率 (%)	31.6%	26.4%	25.8%	18.4% ³	23.6%	31.2%
EBITDA	18,010	4,033	4,472	4,376	12,880	16,233
EBITDA率 (%)	28.8%	25.9%	27.9%	30.2%	27.9%	36.3%
營業淨利	14,118	2,589	2,438	1,230	6,257	9,683
營業淨利率 (%)	22.5%	16.6%	15.2%	8.5%	13.6%	21.6%
稅前淨利	12,429	2,133	2,289	2,187	6,609	10,213
稅前淨利率 (%)	19.8%	13.7%	14.3%	15.1%	14.3%	22.8%
稅後淨利	9,839	1,456	1,682	1,969 ⁴	5,107	7,990
稅後淨利率 (%)	15.7%	9.3%	10.5%	13.6%	11.1%	17.90%
每股盈餘 (NT\$)	21.06	3.05	3.52	4.12	10.68	16.71

備註: 1. 模擬數據排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)

3. 2025 年第 3 季毛利率季減，主要原因包括折舊比例增加、夏季電費與人力成本比例上升，以及擴產相關成本

4. 2025 年第 3 季稅後淨利季增，主因為持有 Siltronic 股票及海外附認股權公司債 (Exchangeable Bond) 的評價利益

5. 2025 年第 3 季有效稅率下降，主因為部分子公司因當地稅務法令變動認列退稅，並回沖前期估列之未分配盈餘稅，且集團區域獲利結構變化，使合併有效稅率較上季下降



資產負債表

新台幣百萬元	2023	2024	Q125	Q225	Q325
資產					
現金及約當現金	26,165	38,929	28,846	22,220	15,947 ³
應收帳款	10,116	10,265	10,845	10,140	10,502
存貨	9,359	11,238	11,953	10,303	10,100
不動產、廠房及設備	72,251	119,074	128,495	114,496	119,944 ⁴
其他資產	71,097	45,074	47,987	49,201	58,553
資產總計	188,988	224,581	228,126	206,361	215,047

現金資產細項包含：	
(新台幣百萬元)	Q325
三個月以上定存	2,937
受限制現金	26,395
債券	6,059

負債					
短期借款 ¹	40,000	28,797	32,975	24,287	32,910 ⁵
應付帳款	5,027	5,371	4,433	3,804	3,794
長期借款 ²	14,542	37,678	39,699	43,055	42,707 ⁵
其他負債	62,966	61,706	60,043	50,334	45,866
負債總計	122,534	133,553	136,449	121,480	125,276

權益總計	66,454	91,028	91,677	84,881	89,770
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

備註：1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債

2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債

3. 2025年第3季現金及約當現金減少，主要反映內部資金重新配置以支應子公司融資需求，並部分重分類至其他流動金融資產

4. 2025年第3季固定資產增加，主要來自擴產

5. 短期借款增加且長期借款減少，主要原因為籌資結構調整，包括將一年內到期的公司債重分類為短期借款，以及發行新的公司債



04

Q&A